**2024-2029年中国数字电视芯片行业市场调查研究与发展战略咨询预测报告**

**报告简介**

高清晰度电视(HDTV)芯片，也就是数字电视芯片。它是整个数字电视系统的接收部分。数字电视从信号源就与模拟电视不同，采用MPEG-Ⅱ格式。HDTV芯片包括解调和解压两部分，解压部分将MPEG-Ⅱ解码和控制部分集成在一起。

随着多项刺激政策的实施以及NGB(下一代广播电视网)建设的启动和提速，我国数字电视产业呈现出越来越好的发展态势。目前来看，数字电视产业已经实现了双向互动、高清等多业态共同发展的局面，有线、地面、卫星、手机电视等多个领域多点开花，在近期更是频频出现芯片告急的现象。一方面多业态共同发展无疑为数字电视芯片行业带来了难得的市场机遇，但另一方面也形成了极大的挑战，如何实现多业态的同步支持，如何实现芯片性能的提升并保持功耗和成本的降低，这些成为摆在芯片企业面前的新课题。而解决这个问题不仅关乎各芯片企业的未来发展，同时也直接影响着中国数字电视产业的整体前景。

目前，数字电视产业链正处于发展的关键期。对于标清和高清节目的不同需求，多标准解码芯片有效地解决了这一难题，目前有些企业已经推出了既能对MPEG2解码，同时又可以对H.264或者AVS进行解码的芯片。目前,数字电视解码标准存在地区差异，比如地面数字电视，大部分地区用的是MPEG2标准，但上海用的是AVS，香港用的是H.264。而多标准解码芯片则可以满足不同地区的需求，有效地解决不同地区解码标准不同的难题。可以预见，未来多标准解码芯片必将受宠。

本报告由中道泰和的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、51行业报告网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个数字电视芯片行业的市场走向和发展趋势。

本报告专业!权威!报告根据数字电视芯片行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国数字电视芯片行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国数字电视芯片行业将面临的机遇与挑战，对数字电视芯片行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是数字电视芯片企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值!

**报告目录**

**第一章 数字电视宏观环境**

第一节 三网融合

第二节 视频传输通道

一、有线数字电视

二、卫星数字电视

三、地面数字电视

四、IPTV

**第二章 2019-2023年中国数字电视产业运行动态分析**

第一节 2019-2023年中国数字电视市场发展分析

一、中国数字电视大事记

二、中国数字电视市场发展现状

三、中国数字电视整机和关键件开发生产情况

四、拉动中国数字电视产业发展的热点

五、数字电视一体机发展分析

六、年京沪数字电视产业发展情况

七、中国地面数字电视信号开通情况及运营特点

第二节 2019-2023年中国数字电视技术标准研究

一、国际主要数字电视标准

二、中国数字电视技术标准战情况

三、中国数字电视技术标准化工作的进展综述

四、等离子数字电视新标准助推产业发展

第三节 2019-2023年中国数字电视存在的问题分析

一、数字电视商业模式问题及创新

二、中国数字电视的发展瓶颈

三、广州数字电视的弊端

**第三章 2019-2023年中国数字电视芯片行业市场发展环境分析**

第一节 国内宏观经济环境分析

一、gdp历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、中国宏观经济发展预测分析

第二节 中国数字电视芯片行业政策环境分析

**第四章 2019-2023年中国数字电视芯片行业运行形势分析**

第一节 2019-2023年中国数字电视芯片发展分析

一、国产数字电视芯片研制取得突破进展

二、usb数字电视芯片及应用

三、中国数字电视打破国外芯片市场垄断

四、中国电子数字电视内容保护芯片研制取得突破进展

五、数字电视终端与芯片的智能化探讨

第二节 2019-2023年中国数字电视芯片技术分析

一、芯片技术发展趋势

二、芯片技术发展对机顶盒的影响

第三节 2019-2023年中国数字电视芯片发展存在问题分析

**第五章 2019-2023年中国数字电视芯片市场运行形势分析**

第一节 2019-2023年中国数字电视芯片市场概述

一、有线市场

二、卫星市场

三、地面市场

四、高清市场

第二节 2019-2023年中国数字电视芯片市场动态分析

一、数字电视芯片供给分析

二、数字电视芯片需求分析

三、数字电视芯片价格分析

第三节 2019-2023年中国数字电视芯片市场销售分析

**第六章 2019-2023年中国数字电视芯片竞争格局分析**

第一节 2019-2023年中国数字电视芯片竞争现状

一、竞争主体及类别

二、国内外芯片厂商之间的竞争

第二节 2019-2023年中国数字电视芯片行业集中度分析

一、数字电视芯片市场集中度分析

二、数字电视芯片企业集中度分析

第三节 2019-2023年中国数字电视芯片企业竞争力策略分析

**第七章 2019-2023年中国主流芯片厂商竞争力分析**

第一节 st意法半导体

第二节 fujitsu富士通

第三节 nec日电电子(瑞萨电子)

第四节 zoran卓然

第五节 nxp恩智浦

第六节 broadcom博通

第七节 intel英特尔

第八节 ti德州仪器

第九节 magnum

第十节 sunplus凌阳科技

第十一节 ali扬智科技

第十二节 novatek(cheertek)联咏科技

第十三节 amlogic晶晨半导体

第十四节 maxscend卓胜微电子

第十五节 haier海尔集成

第十六节 hdic上海高清

第十七节 legendsilicon凌讯科技

第十八节 nationalchip杭州国芯

第十九节 availink中天联科

第二十节 hisilicon海思半导体

第二十一节 澜起科技

第二十二节 龙晶微电子

第二十三节 微纳电子

**第八章 2019-2023年我国芯片设计行业运行新形势透析**

第一节 2019-2023年中国芯片设计行业运行总况

一、行业规模不断扩大

二、行业质量稳步提高

三、产品结构极大丰富

四、原材料与生产设备配套问题

第二节 2019-2023年中国芯片设计运行动态分析

一、产业持续快速发展，但增速呈逐年放缓趋势

二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇

三、模拟ic和电源管理芯片成为国内ic设计热门产品

第三节 2019-2023年中国芯片设计行业经济运行分析

一、2019-2023年行业经济指标运行

二、芯片设计业进出口贸易现状

三、行业盈利能力与成长性分析

第四节 2019-2023年中国芯片设计行业发展中存在的问题

一、企业规模问题分析

二、产业链问题分析

三、资金问题分析

四、人才问题分析

五、发展的建议与措施

**第九章 2024-2029年中国数字电视芯片行业发展趋势及盈利预测分析**

第一节 2024-2029年中国数字电视芯片产业发展前景分析

一、数字电视芯片技术方向分析

二、数字电视芯片价格预测分析

第二节 2024-2029年中国数字电视芯片市场预测分析

一、数字电视芯片市场供给预测分析

二、数字电视芯片需求预测分析

三、数字电视芯片竞争格局预测分析

第三节 2024-2029年中国数字电视芯片产业市场盈利预测分析

**第十章 2024-2029年中国数字电视芯片行业投资机会与风险规避分析**

第一节 2024-2029年中国数字电视芯片行业投资机会分析

一、数字电视芯片投资潜力分析

二、数字电视芯片投资吸引力分析

第二节 2024-2029年中国数字电视芯片行业投资风险分析

一、数字电视芯片行业竞争风险

二、数字电视芯片技术风险分析

三、政策风险分析

**图表目录**

图表：2019-2023年国内生产总值

图表：2019-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2019-2023年居民消费价格比上年涨跌幅度(%)

图表：2019-2023年国家外汇储备

图表：2019-2023年财政收入

图表：2019-2023年全社会固定资产投资

图表：2019-2023年分行业城镇固定资产投资及其增长速度(亿元)

图表：2019-2023年固定资产投资新增主要生产能力

图表：数字电视芯片竞争厂商一览表

图表：芯片厂商产品类型一览表

图表：芯片厂商与机顶盒厂商合作情况一览表

图表：2019-2023年 st意法半导体公司mpeg解码器ic出货量

图表：st有线机顶盒芯片产品一览表

图表：st有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：富士通数字电视解决方案一览表

图表：富士通有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：nec日电电子数字av产品

图表：日电电子用于机顶盒/数字电视的emma应用

图表：日电电子用于机顶盒的mpeg解码器产品阵容

图表：日电电子基于emma的系列机顶盒解决方案

图表：nec有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：zoran机顶盒芯片方案一览表

图表：zoran机顶盒芯片supratv 160系统框图

图表：卓然有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：恩智浦STB225结构示意图

图表：broadcom bcm7405芯片解决方案

图表：博通有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：ti数字机顶盒(stb/pvr)设计方案示意图

图表：lsi sc2000芯片解决方案

图表：sunplus凌阳科技机顶盒芯片产品一览表

图表：ali机顶盒解决方案一览表

图表：卓胜微电子产品一览表

图表：海尔集成芯片产品一览表

图表：海尔基于hi2011芯片平台完成的dmb-t系统示意图

图表：海尔集成机顶盒整体解决方案

图表：上海高清国标产品一览表

图表：上海高清adtb-t解调芯片一览表

图表：上海高清国标解调芯片hd2815内部结构图

图表：凌讯科技数字电视芯片产品一览表

图表：凌讯科技tds-ofdm解调芯片一览表

图表：凌讯科技信道解调芯片lgs-8g52芯片示意图

图表：杭州国芯数字电视芯片一览表

图表：中天联科基于avl2108的卫星数字电视接收机前端设计示意图

图表：中天联科avl2108芯片内部结构示意图

图表：中天联科基于avl3106的地面数字电视接收机前端设计示意图

图表：海思hi3110q应用领域及典型应用图

图表：海思半导体数字电视机顶盒解决方案一览表

图表：海思半导体有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：澜起科技数字电视芯片一览表

图表：龙晶微电子avs1.0解码专用芯片ds1000的架构

图表：龙晶微电子有线机顶盒解决方案系统框架图

图表：微纳电子中视一号典型应用图

图表：有线机顶盒芯片各地应用情况一览表

**把握投资 决策经营！**
**咨询订购 请拨打 400-886-7071 邮件 kf@51baogao.cn**
本文地址：https://www.51baogao.cn/sc/20191211/150174.shtml

[在线订购>>](https://www.51baogao.cn/sc/20191211/150174.shtml)